聚硅氧烷改性及多模光波导制备

冯向华1,3 季家镕1 窦文华2

1 国防科学技术大学光电科学与工程学院,湖南长沙 410073

²国防科学技术大学计算机学院,湖南长沙410073

³ 解放军信息工程大学理学院,河南 郑州 450001

摘要 采用含氢聚硅氧烷(HPSO)和二乙烯基苯(DVB)的交联体掺入聚二甲基硅氧烷(PDMS)中,使改性的聚二 甲基硅氧烷(M-PDMS)折射率发生1%~1.8%的改变。M-PDMS及PDMS薄膜具有良好的光透射率和低的传输 损耗,是低成本制备用于高速芯片间光互连聚合物光波导的理想材料。采用软成型和图案转移法,用 M-PDMS及 PDMS分别作波导的芯层和包层制备了截面为50 μm×50 μm,长度大于20 cm 的聚硅氧烷多模光波导。用数字化 散射法测量了所制备波导的传输损耗,测得输入光波长为633 nm 时平均传输损耗为0.137 dB/cm。

关键词 薄膜;芯片间光互连;聚硅氧烷波导;交联体;图案转移法;传输损耗

中图分类号 TN252 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201232.0531003

Fabrication of Modified Polydimethylsiloxane and Multimode Optical Waveguides

Feng Xianghua^{1,3} Ji Jiarong¹ Dou Wenhua²

¹ College of Optoelectronic Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China

² College of Computer, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China ³ College of Science, Information Engineering University, Zhengzhou, Henan 450001, China

Abstract The modified polydimethylsiloxane (M-PDMS) is synthesized by adulterating cross-linking of polysiloxane (HPSO) and divinylbenzene (DVB) into polydimethylsiloxane (PDMS). M-PDMS refractive index contrast PDMS are changed by $1\% \sim 1.8\%$. PDMS and M-PDMS bulk samples have well transmittance and low propagation loss. These benefits realize high productivity and low-cost mass production of large core multimode optical waveguides for optical interconnection. M-PDMS and PDMS are used for the core layer and the cladding layer. Large core($50 \ \mu m \times 50 \ \mu m$) multimode optical waveguides are fabricated by the soft molding and simple replication, the length of waveguides is more than 20 cm. The optical propagation loss of waveguides is $0.137 \ dB/cm$ measured by digital scattering method at 633 nm.

Key words thin films; inter-chip optical interconnection; polysiloxane waveguide; cross-linking; pattern transfer method; propagation loss

OCIS codes 310.2790; 130.5460; 200.4650; 230.7370

1 引 言

近年来,光学互连研究重点集中在如何将光学 功能器件单元集成到传统的印制电路板上,特别是 应用聚合物光波导作为光层集成到印制电路板上, 制成光电印制电路板(OEPCB)^[1~4],实现芯片间光 互连。由于聚硅氧烷光波导具有在 850 nm 的互联 波长窗口高度透明性,高度的温度稳定性;能承受标 准多层印制电路板 180 ℃的层压处理 2 h 和 230 ℃

收稿日期: 2011-11-21; 收到修改稿日期: 2011-12-07

基金项目:国家 973 计划(2012CB933504)资助课题。

作者简介:冯向华(1965—),女,副教授,主要从事非线性光学、光通信器件的应用等方面的研究。

E-mail: fengxianghua2002@hotmail.com

的锡焊处理 2 min;成本效益低,适合大规模生产的 优势,一直受到关注,并成为研究的热点^[5~8]。Zhu 等^[8]使用标准商用聚二甲基硅氧烷(PDMS)和德国 Wacker 公司的特殊产品做波导的包层和芯层,测试 出 PDMS 波导具有良好的温度、湿度等稳定性。

制备波导首先要得到合适折射率的芯层和包层 聚合物,目前已经研究和使用的方法有光漂白法^[9], 凝胶溶胶法混杂有机硅烷法^[10]等。由于要制备适合 芯片间光互连的大尺寸长波导,不仅要求聚合物的折 射率合适,还要求聚合物对采用的制作工艺适宜。本 文采用含氢聚硅氧烷(HPSO)和二乙烯基苯(DVB)的 交联体掺入 PDMS 中,使 PDMS 的折射率发生 1%~ 1.8%的改变;采用软成型和图案转移法,制备了长度 大于 20 cm 的聚硅氧烷多模光波导,波导平均传输损 耗为 0.137 dB/cm。

2 实 验

2.1 聚合物原料

PDMS:无色透明液体,主体与固化剂按10:1比 例混合后室温动力粘度为4 Pa•s,在可见光波段理 论上接近 100%透光率,具有很好的透光性。 HPSO:无色透明液体,室温动力粘度 24 mPa•s,含 氢 1.4%(质量分数),分子式如图 1 所示,其中 m 和 n 为整数。DVB:淡黄色透明液体,室温下粘度小于 10 mPa•s,工业纯,用作 HPSO 的交联剂。氯铂酸 (H₂PtCl6•6H₂O):分析纯,溶于无水乙醇,用作 HPSO 与 DVB 交联反应的催化剂。HPSO 与 DVB 在低温下交联为脆性固体^[11],它容易被磨细成微 粉,在 370 °C~800 °C时裂解可得陶瓷微粉,被认为





是低成本制备高性能陶瓷材料的理想先驱体。图 2 为 HPSO 与 DVB 交联产物的结构示意图,从图中 看出苯环已交联到碳键上。

2.2 样品折射率及传输损耗

HPSO与 DVB 交联为脆性固体,不能成膜。 采用 PDMS、固化剂、HPSO、DVB 四种液体分别按 3 种容积比:10:1:5:2、10:1:5:2.5 和 10:1:5:3混 合,75 ℃时加热 20 min,然后继续加热在 100 ℃下 保持 10 min,断电后自然降温,固化后均成透明薄 膜为改性的聚二甲基硅氧烷(M-PDMS)。M-PDMS 折射率用阿贝折射仪测量,在室温下,折射率 与 DVB 所占容积份额的关系如图 3 所示。由图 3 可以看出 DVB 容积份额的增加可提高聚合物的折 射率,与 DVB 交联的苯环数量相关。固化成膜后 的折射率对应 3 种容积比分别为 1.4280、1.4310 和 1.4365。





PDMS 与固化剂按 10:1比例混合,在 21 ℃时测 得折射率 n=1. 4150,在恒温箱中 75 ℃保持 20 min 制备成 PDMS 薄膜,成膜后测得折射率为 n=1. 4180。

由分光光度计 Japan HITACH IU-4100 测得 PDMS 透射率光谱如图 4 中实线所示,传输损耗如 图 5 中实线所示。测到 M-PDMS 固化后折射率为 1.4280 的薄膜透射率光谱如图 4 中虚线所示,传输 损耗如图 5 中实线所示。

从样品的透射率和传输损耗图中可以看出,改性 后折射率为 1.4280 薄膜的透射率对比改性前略有减 少,传输损耗对比改性前略有增加,但改性后材料同 样满足近红外波段透射率高,在 1.3 μm 处损耗小于 0.05 dB/cm,在 1.55 μm 处损耗小于 0.15 dB/cm,在 0.85 μm 处的损耗小于 0.05 dB/cm;还具有的优点





为:热稳定性优异(含-Si-O-主链),在-50℃~200℃稳定且有弹性。所以极其适宜用于通讯波段为850 nm的芯片间光互连系统。

在制备陶瓷材料时,氯铂酸用作 HPSO 与 DVB 交联反应的催化剂,可以提高交联样品的凝胶含量。 但在多次实验中发现,氯铂酸酒精溶液的淡黄色会 影响膜的透明度,在材料固化的过程中酒精的存在 容易形成气泡,影响成膜质量,所以在薄膜和波导的 制备过程没有使用氯铂酸做催化剂。实验中通过提 高反应温度和延长固化时间来增加材料的交联 程度。

3 光波导制备及传输损耗

所制备光波导的设计尺寸为 50 μm×50 μm,芯 层和包层的材料分别为 M-PDMS 和 PDMS。考虑 到波导较长,所以选用的芯层折射率在常温下为 1.4280,与包层折射率1.4180 相差 0.1%。制备工 艺采用软成型和图案转移制备技术^[12,13],步骤如 图 6所示:含有芯层图案模板的制备;用机械式直涂 法涂覆包层材料在模板上,图案转移,直接得到下包 层;用芯层材料填充包层上图案凹槽做芯层,用包层 材料涂覆在包含芯层的下包层之上做上包层,固化 形成波导阵列。得到光波导阵列长度大于 20 cm, 图 7 为所制备的 12 条光波导的扫描电镜图像,图中 相邻波导的中心相距 250 μm,可同时传输 12 路光 信号。



- 图 6 聚硅氧烷光波导的制备工艺流程图。1:模板, 2:下包层,3:芯层,4:上包层
- Fig. 6 Fabrication process for polysiloxane optical waveguide. 1: hard mould, 2: under-cladding; 3: core, 4: over-cladding



图 7 12 条光波导的扫描电镜图像

Fig. 7 Scanning electron microscope image of the 12 ridge waveguide arrays

采用 PDMS 及其改性材料制备波导优势为: PDMS 膜柔软并具有低的表面能,即使模板面积大 也容易从模版上脱模;可以制作任意形状、任意尺寸 的波导;且 M-PDMS 与 PDMS 同种基质材料物理 化学特性匹配,在包层上填充芯层材料时易于操作。 但对界面的光滑程度要求较高,即要求模具表面微 观起伏的均方差越小越好。

由有效折射率法^[14],按照所制备的波导尺寸, 固定包层折射率 1.418,理论计算出传输模式数随 芯层折射率的关系如图 8 所示,从图中可以看出传 输模式数随芯层折射率逐渐接近包层折射率而减 少。本波导芯层包层折射率相差 Δ*n*=0.01,在同样 的波导尺寸下传输模式少,相应的传输损耗减少;波导的数值孔径 $NA = \sqrt{1.428^2 - 1.418^2} \approx 0.169$,接近通信常用光纤的数值孔径在 $0.18 \sim 0.23$,适用光 纤与波导的直接耦合。



图 8 波导中 TE 模式数与芯层折射率的关系 Fig. 8 Relation between TE mode number and core refractive index

采用数字化散射法分段测出输入波长为633 nm 时波导光功率传输损耗,该方法的原理^[15]为采用数 字成像器件 CCD 对传输线上各点的散射光强进 行记录,转换成内部传输光强,用中值滤波处理消除



图像中的尖锐噪声, 拟合出传输衰减曲线并计算衰减 系数, 从而计算出波导的传输损耗。

实验中沿波导测量了 11 段样品的传输损耗值, 图 9 为其中的一小段波导的 CCD 数字成像图,图 10 为测量的两小段波导 a 段和 b 段散射光强分布图。 波导中的杂质或缺陷会造成散射光强的涨落,但由于 整段波导是在特定条件下一次性制备,所以杂质或缺 陷的影响可以认为在整段波导中平均分布。由拟合 出的传输衰减曲线计算出 a 段波导的传输损耗为 0.124 dB/cm,b 段波导的传输损耗 0.152 dB/cm。对 整段波导 11 段测量结果的平均值为 0.137 dB/cm。







图 10 散射光强度分布图。(a) a 段波导;(b) b 段波导 Fig. 10 Scattering light intensity distribution along propagation length. (a) a segment waveguide; (b) b segment waveguide

4 结 论

采用 HPSO 和 DVB 的交联体掺入 PDMS 中, 使 M-PDMS 的折射率发生 1.0%~1.8%的改变, 但其光透射率和传输损耗与 PDMS 相差很小;由于 用 M-PDMS 的芯层和 PDMS 的包层折射率相差很 小,在大截面的波导中减少了传输模式,并且波导的 数值孔径与常用光纤的数值孔径相差小,适宜光纤 与波导的直接耦合。采用软成型和图案转移法,制 备了长度大于 20 cm 的聚硅氧烷多模光波导,输入 光波长为 633 nm 时波导平均传输损耗为 0.137 dB/cm。用此材料制备大尺寸长波导,可使 波导的制备工艺简单、易于操作,成本低廉。本文所 用聚合物材料和制备方法还适用于其它光波导器件 的制备,在芯片间光互联高速数据传输方面具有十 分光明的应用前景。

参考文献

¹ Xiaolong Wang, Wei Jiang, Li Wang et al.. Fully embedded board-level optical interconnects from waveguide fabrication to device integration [J]. J. Lightwave Technol., 2008, 26(2): 243~250

- 2 T. Mikawa, M. Kinoshita, K. Hiruma *et al.*. Implementation of active interposer for high-speed and low-cost chip level optical interconnects[J]. *IEEE J. Sel. Topics Quantum Electronics*, 2003, 9(2): 452~459
- 3 Ni Wei, Wu Xingkun. Soft-lithography-based inter-chip optical interconnection circuit [J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(5): 813~818

倪 玮,吴兴坤.基于软光刻的片间光学互连线路[J].光学学报,2007,**27**(5):813~818

- 4 Liu Yanting, Ni Wei, Wu Xingkun. A soft-lithography-based vertically coupling structure for multilayered optical interconnection[J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28(2): 349~354 刘彦婷,倪 玮,吴兴坤. 基于软光刻的多层光互连垂直耦合结 构[J]. 光学学报, 2008, 28(2): 349~354
- 5 S. Kopetz, E. Rabe, W. J. Kang *et al.*. Polysiloxane optical waveguide layer integrated in printed circuit board[J]. *Electron*. *Lett.*, 2004, **40**(11): 668~669
- 6 A. Neyer, S. Kopetz, E. Rabe *et al.*. Electrical-optical circuit board using polysiloxane optical waveguide layer [C]. Orland: Electronic Components and Technology Conference, FL, 2005, 246~250
- 7 Sung Hwan Cho. Optofluidic waveguides in teflon AF-coated PDMS microfluidic channels[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2009, **21**(15): 1057~1059
- 8 D. Zhu, D. Cai, S. Kopetz *et al.*. Environmental stability of PDMS waveguides for electrical-optical circuit boards [J]. *Electron. Lett.*, 2007, **43**(11): 627~628
- 9 Tong Canming, Chen Baoxue, He Lei et al.. Study on poly (Methylphenylsilane)-poly (benzylMethacrylate) copolymer waveguide fabricated by photobleaching [J]. Acta Optica Sinica, 2110, 30(6): 1613~1617

童灿明,陈抱雪,何 磊等.光漂白法制备 PMPS-PBzMA 共聚 物光波导的技术研究[J].光学学报,2010,**30**(6):1613~1617

- 10 Woo-Soo Kim, Jong-Hwan Lee, Sang-Yung Shin et al.. Fabrication of ridge waveguides by UV embossing and stamping of sol-gel hybrid materials[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2004, 16(8): 1888~1890
- 11 Ma Qingsong, Chen Zhaohui, Zheng Wenwei *et al.*. Curing of polysiloxane and its pyrolytic conversion to ceramics[J]. *Polymer Materials Science and Engineering*, 2005, **21**(2): 279~282
 马青松,陈朝辉,郑文伟等. 聚硅氧烷/二乙烯基苯的交联与裂解陶瓷化研究[J]. 高分子材料科学与工程, 2005, **21**(2): 279~282
- 12 Feng Xianghua, Weng Changli, Ji Jiarong *et al.*. Studying of polysiloxane multimode optical ridge waveguides applying in optical interconnection [J]. *J. Optoelectronics Laser*, 2011, 22(1): 38~41
 冯向华,温昌礼,季家镕等.用于光互连的聚硅氧烷脊型光波导研究[J]. 光电子•激光, 2011, 22(1): 38~41
- 13 Feng Xianghua, Ji Jiarong, Dou Wenhua *et al.*. Fabrication of polysiloxane optical ridge waveguides for optical interconnection [C]. SPIE, 2010, 7847: 784723
- 14 Ji Jiarong, Feng Ying. High Optics Tutorial [M]. Beijing: Science Press, 2008. 243~248
 季家镕,冯 莹. 高等光学教程[M]. 北京:科学出版社, 2008. 243~248
 15 Jiang Yi, Cao Zhuangqi, Qiu Linlin *et al.*. Digital measurements
- and fabrication of low loss optical organic polymer waveguides
 [J]. Acta Optica Sinica, 1999, 19(8): 1142~1145
 蒋 毅,曹庄琪,仇琳琳等.低损耗有机聚合物光波导的制备及
 其数字化测量技术[J]. 光学学报, 1999, 19(8): 1142~1145

栏目编辑:韩 峰